

电子

周跟踪 (20240527-20240602)

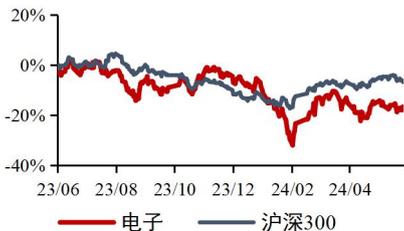
领先大市-A(维持)

3440 亿国家大基金三期落地，台积电扩张先进制程和先进封装产能

2024 年 6 月 3 日

行业研究/行业周报

电子行业近一年市场表现



资料来源：最闻

相关报告：

【山证电子】山西证券电子行业周跟踪：三大原厂提高先进制程投片，HBM 需求持续看增 2024.5.27

【山证电子】OpenAI 发布新一代模型 GPT-4o，Q1 全球半导体制造业改善-山西证券电子行业周跟踪 2024.5.20

分析师：

高宇洋

执业登记编码：S0760523050002

邮箱：gaoyuyang@sxzq.com

徐怡然

执业登记编码：S0760522050001

邮箱：xuyiran@sxzq.com

投资要点

➢ **市场整体：**本周（2024.05.27-05.31）市场涨跌不一，上证指数跌 0.07%，深圳成指跌 0.64%，创业板指数跌 0.74%，科创 50 涨 2.20%，申万电子指数涨 2.84%，Wind 半导体指数涨 4.93%，费城半导体指数跌 1.87%，台湾半导体指数跌 3.82%。细分板块中，周涨跌幅前三为集成电路封测（+6.49%）、电子化学品（+6.26%）、模拟芯片设计（+6.18%）。从个股看，涨幅前五为：骏成科技（+44.35%）、上海贝岭（+39.68%）、国科微（+38.69%）、台基股份（+37.62%）、容大感光（+32.97%）；跌幅前五为：鼎通科技（-31.16%）、萤石网络（-30.16%）、唯特偶（-30.10%）、好上好（-26.04%）、*ST 超华（-23.01%）。

➢ **行业新闻：**3,440 亿国家大基金三期落地。国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司已于 5 月 24 日注册成立，国家大基金三期注册资本为 3440 亿元人民币，国有六大行出资占比达 37.06%。**台积电 2024 技术大会：AI 芯片需求翻番，今年狂建 7 厂。**展望未来 AI 创新，高性能计算、3D 芯片堆叠、封装技术日趋重要。台积电目前积极扩张先进制程和先进封装产能，2022 年到 2023 年台积电新建了五座工厂，今年在建有七座工厂（三个晶圆厂、两个封装厂、两个海外晶圆厂），今年先进制程占 67%。**1-4 月，我国电子信息制造业生产稳步增长，出口恢复向好，效益持续改善。**1-4 月，规模以上电子信息制造业增加值同比+13.6%，出口交货值同比+0.2%，营收同比+7.9%，利润同比+75.8%。

➢ **重要公告：**【必易微】拟实施 2024 年第二期限限制性股票激励计划，以 15.00 元/股的授予价格向 8 名激励对象授予限制性股票 86.00 万股，约占公司总股本 1.25%。【美格智能】拟实施 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划，以 21.10 元/份的行权价格向激励对象授予 210 万份股票期权，占总股本 0.80%，以 10.55 元/股的授予价格向激励对象授予 401.00 万股限制性股票，占总股本 1.53%。【天禄科技】子公司安徽吉光与英彼克签订《薄膜流延机采购合同》，购买薄膜流延机及其配套设备，合同金额为 7,800 万元（含税）。

投资建议

➢ 我国电子信息制造业整体稳步恢复向好，行业整体增势明显。随着 3440 亿国家大基金三期落地，半导体国产化将加速突破，预计先进封装、HBM 产业链、AI 芯片相关产业链和半导体卡脖子设备、材料、零部件将成为重点投资方向。又因为 AI 和 HPC 需求旺盛，上游晶圆厂积极扩张先进制程和先进封装产能。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及 AI 手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

风险提示

➢ 下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。



目录

1. 行情回顾.....	4
1.1 市场整体行情.....	4
1.2 细分板块行情.....	4
1.2.1 涨跌幅.....	4
1.2.2 估值.....	5
1.3 个股公司行情.....	6
2. 数据跟踪.....	6
3. 新闻公告.....	9
3.1 重大事项.....	9
3.2 行业新闻.....	10
4. 风险提示.....	11

图表目录

图 1： 主要大盘和电子指数周涨跌幅.....	4
图 2： 周涨跌幅集成电路封测、电子化学品、模拟芯片设计领先.....	4
图 3： 月涨跌幅集成电路封测、消费电子、电子化学品表现领先（30 日滚动）.....	5
图 4： 年初至今涨跌幅元件、半导体设备、消费电子表现领先.....	5
图 5： 半数板块当前 P/E 在历史平均值附近.....	5
图 6： 多数板块当前 P/B 低于历史平均值.....	5
图 7： 本周个股涨幅前五.....	6
图 8： 本周个股跌幅前五.....	6
图 9： 全球半导体月度销售额及增速.....	6



图 10: 分地区半导体销售额.....	6
图 11: 中国集成电路行业进口情况.....	7
图 12: 中国集成电路行业出口情况.....	7
图 13: 中国大陆半导体设备销售额.....	7
图 14: 北美半导体设备销售额.....	7
图 15: 日本半导体设备销售额.....	7
图 16: 全球硅片出货面积.....	7
图 17: NAND 现货平均价.....	8
图 18: DRAM 现货均价.....	8
图 19: 半导体封装材料进口情况.....	8
图 20: 半导体封装材料出口情况.....	8
图 21: 半导体封装材料进出口均价.....	8
图 22: 晶圆厂稼动率 (%)	9
图 23: 晶圆厂 ASP (美元/片)	9
表 1: 本周重大事项.....	9
表 2: 本周重要行业新闻.....	10

1. 行情回顾

1.1 市场整体行情

本周（2024.05.27-05.31）市场涨跌不一，上证指数跌 0.07%，深圳成指跌 0.64%，创业板指数跌 0.74%，科创 50 涨 2.20%，申万电子指数涨 2.84%，Wind 半导体指数涨 4.93%，费城半导体指数跌 1.87%，台湾半导体指数跌 3.82%。

图 1：主要大盘和电子指数周涨跌幅

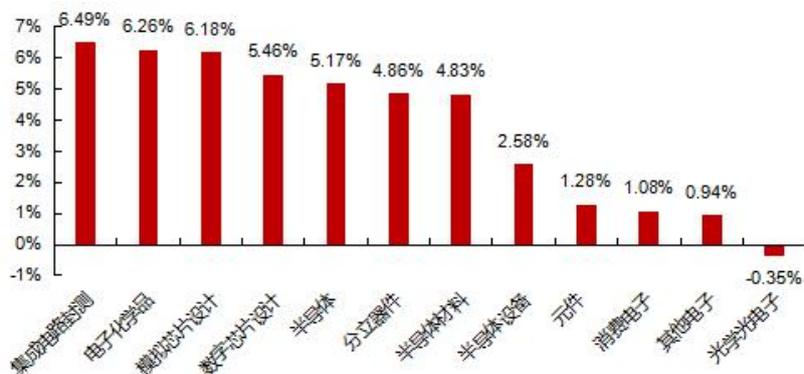


资料来源：Wind，山西证券研究所

1.2 细分板块行情

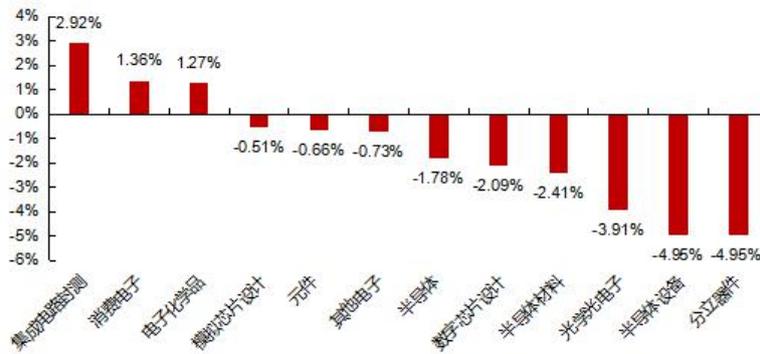
1.2.1 涨跌幅

图 2：周涨跌幅集成电路封测、电子化学品、模拟芯片设计领先



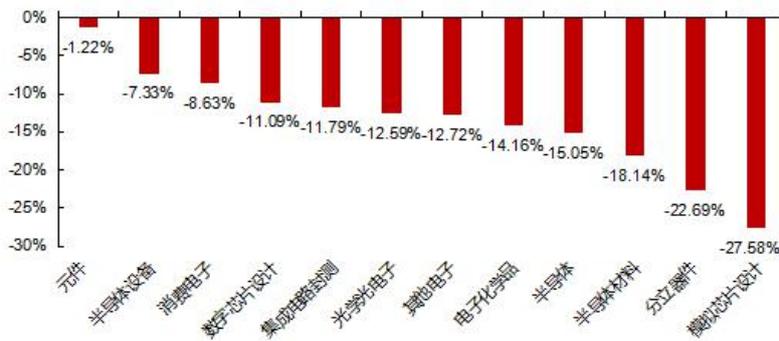
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 3：月涨跌幅集成电路封测、消费电子、电子化学品表现领先（30 日滚动）



资料来源：Wind，山西证券研究所

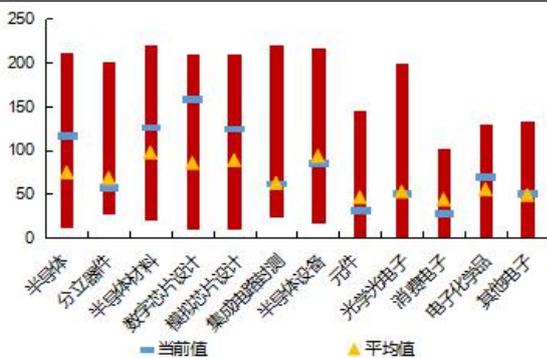
图 4：年初至今涨跌幅元件、半导体设备、消费电子表现领先



资料来源：Wind，山西证券研究所

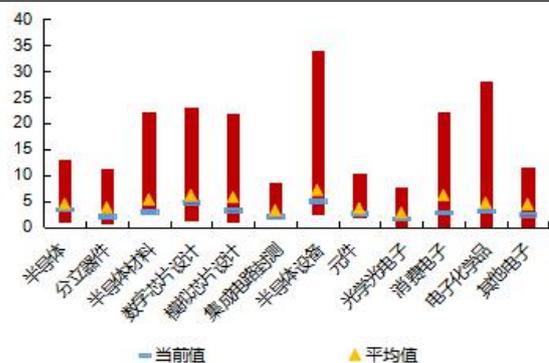
1.2.2 估值

图 5：半数板块当前 P/E 在历史平均值附近



资料来源：Wind，山西证券研究所

图 6：多数板块当前 P/B 低于历史平均值

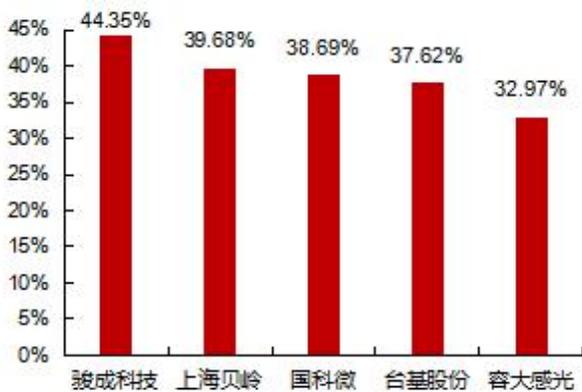


资料来源：Wind，山西证券研究所

1.3 个股公司行情

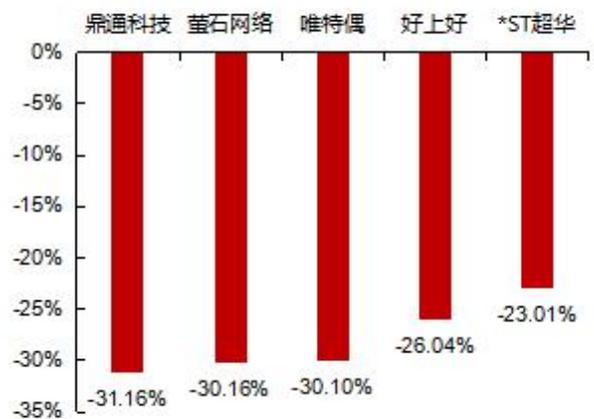
从个股情况看，骏成科技、上海贝岭、国科微、台基股份、容大感光涨幅领先，涨幅分别为44.35%、39.68%、38.69%、37.62%、32.97%；鼎通科技、萤石网络、唯特偶、好上好、*ST超华跌幅居前，跌幅分别为-31.16%、-30.16%、-30.10%、-26.04%、-23.01%。

图 7：本周个股涨幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

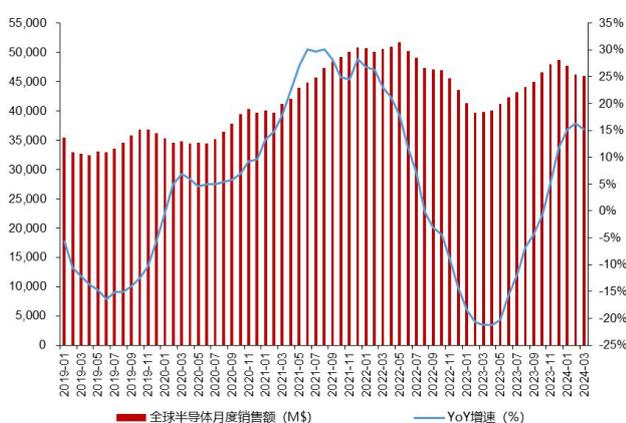
图 8：本周个股跌幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

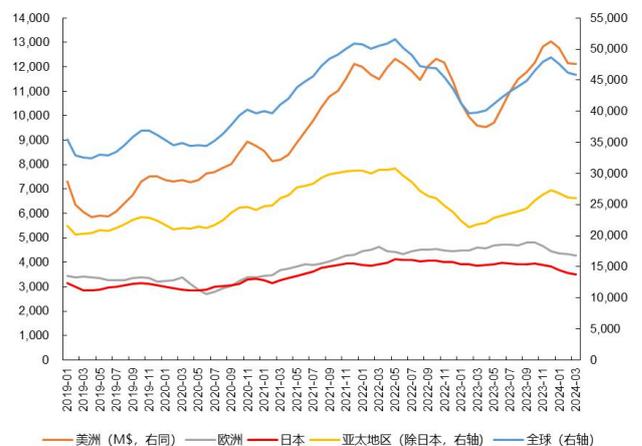
2. 数据跟踪

图 9：全球半导体月度销售额及增速



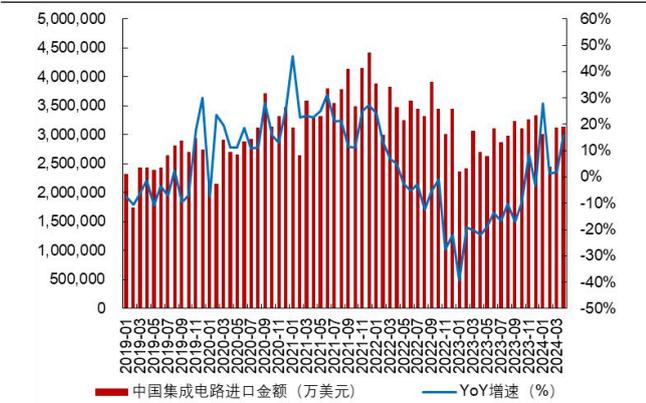
资料来源：WSTS，山西证券研究所

图 10：分地区半导体销售额



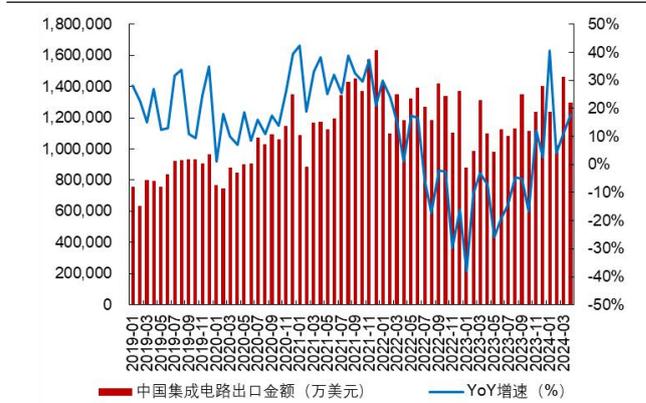
资料来源：WSTS，山西证券研究所

图 11: 中国集成电路行业进口情况



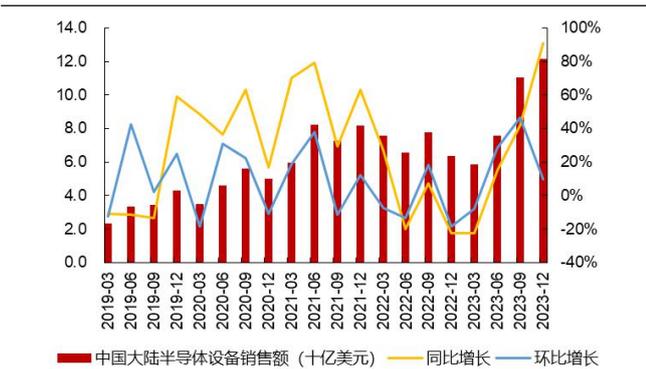
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 12: 中国集成电路行业出口情况



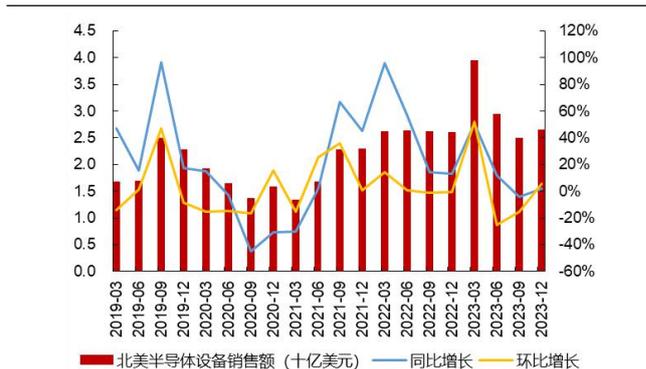
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 13: 中国大陆半导体设备销售额



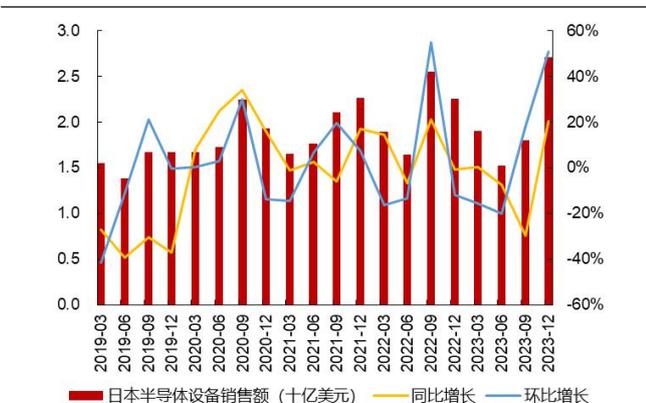
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 14: 北美半导体设备销售额



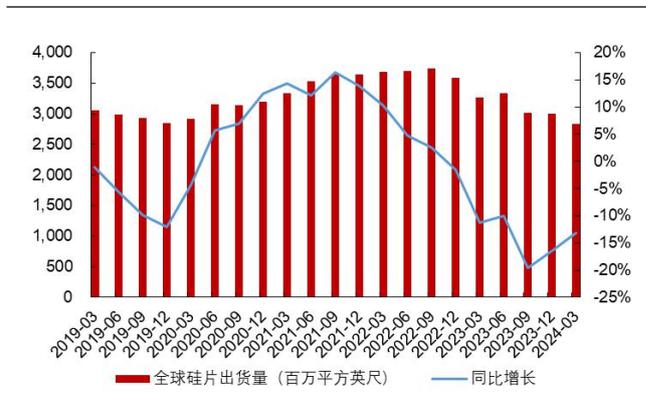
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 15: 日本半导体设备销售额



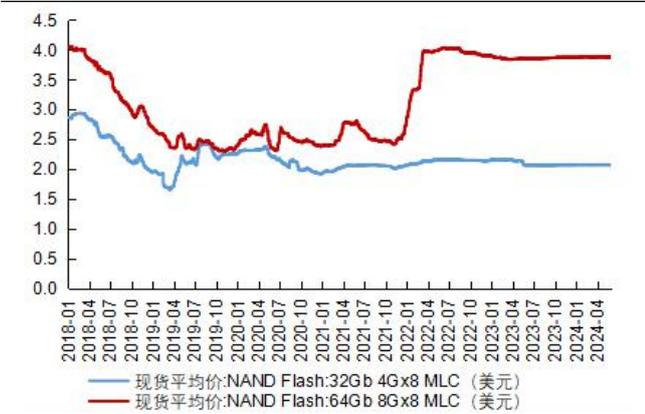
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 16: 全球硅片出货面积



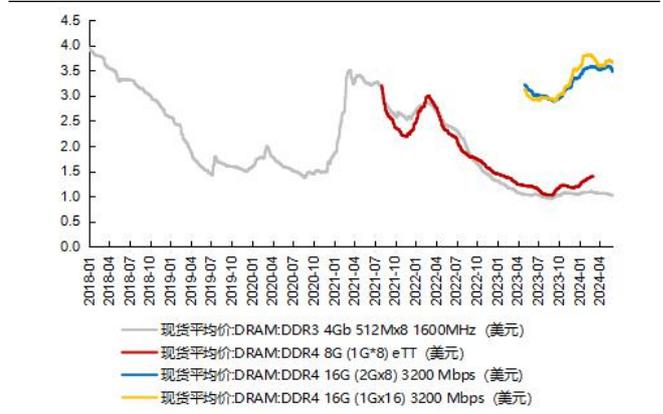
资料来源: SEMI, 山西证券研究所

图 17: NAND 现货均价



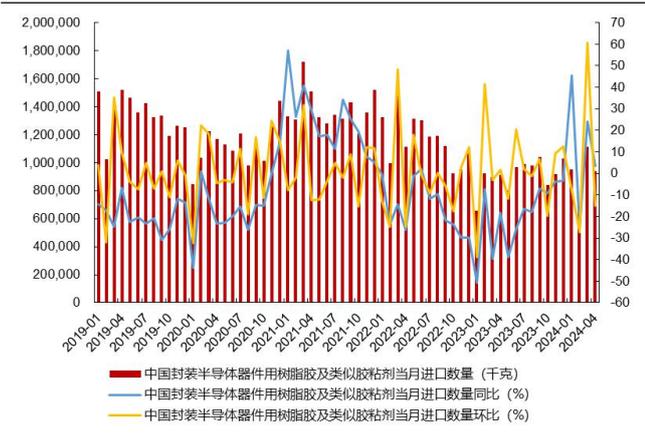
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 18: DRAM 现货均价



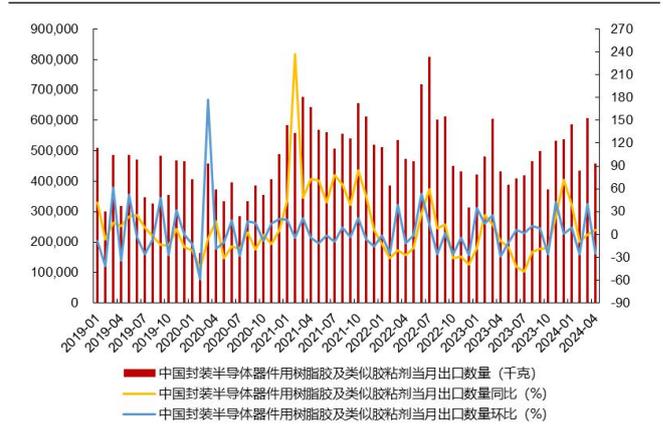
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 19: 半导体封装材料进口情况



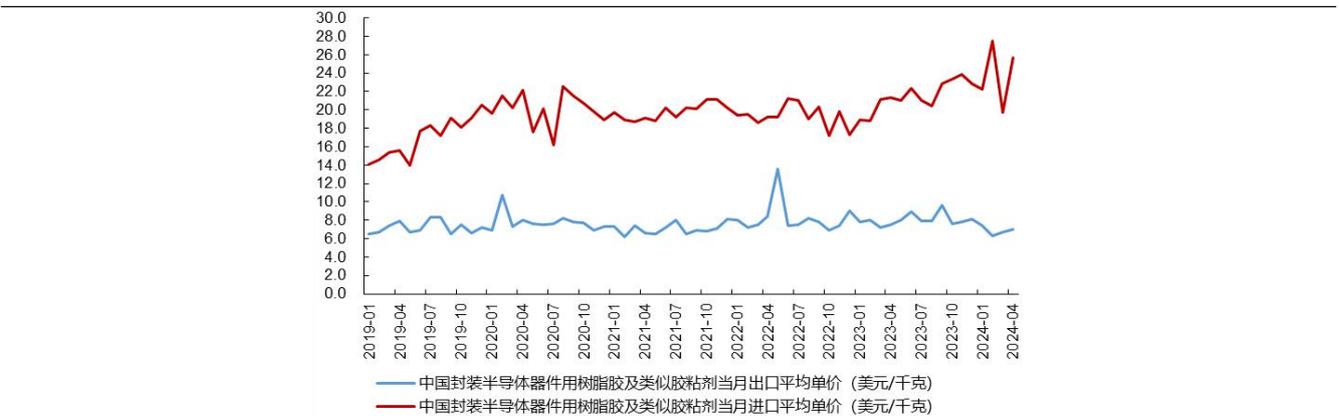
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 20: 半导体封装材料出口情况



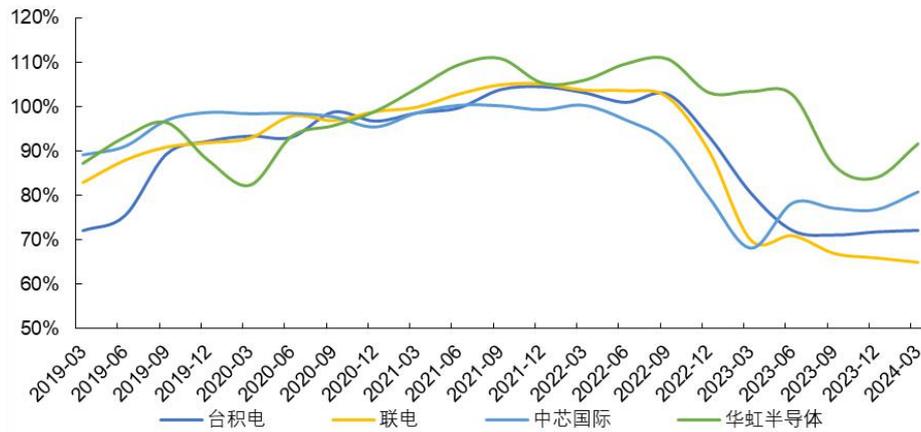
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 21: 半导体封装材料进出口均价



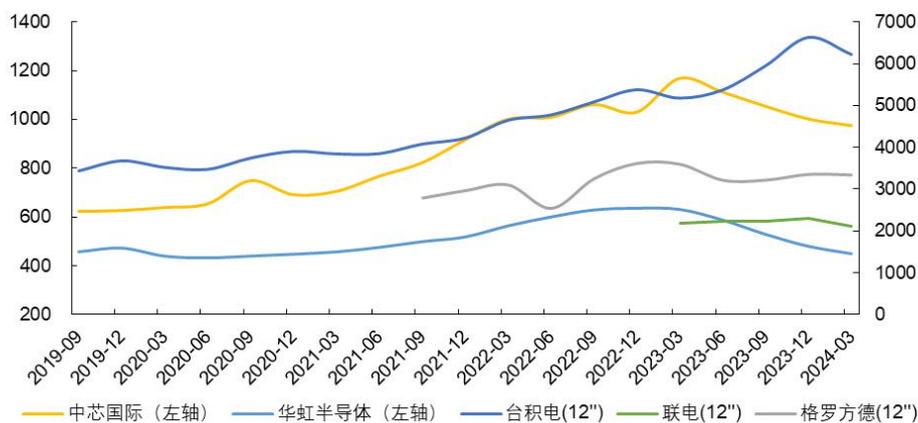
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 22：晶圆厂稼动率（%）



资料来源：各公司季报，山西证券研究所

图 23：晶圆厂 ASP（美元/片）



资料来源：各公司季报，山西证券研究所

3. 新闻公告

3.1 重大事项

表 1：本周重大事项

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2024 年 5 月 27 日					
2024 年 5 月 28 日			波导股份、声讯股份		
2024 年 5 月 29 日	洲明科技		芯朋微		

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2024年5月30日		宸展光电			
2024年5月31日	风华高科		浙江恒威		
2024年6月1日	鼎龙股份				

资料来源：Wind，山西证券研究所

3.2 行业新闻

表 2：本周重要行业新闻

时间	内容	来源
2024年5月27日	国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司已于5月24日注册成立。 国家大基金三期注册资本为3440亿元人民币，国有六大行出资占比达37.06%。2014年6月，经国务院批准，工业和信息化部会同有关部门发布了《国家集成电路产业发展推进纲要》（下称《纲要》），作为今后一段时期指导我国集成电路产业发展的纲领性文件。其中，《纲要》明确，设立国家集成电路产业投资基金，重点吸引大型企业、金融机构以及社会资金对基金进行出资。基金实行市场化、专业化运作，减少政府对资源的直接配置，推动资源配置依据市场规则、市场竞争实现效益最大化和效率最优化。基金支持围绕产业链布局，重点支持集成电路制造领域，兼顾设计、封装测试、装备、材料环节，推动企业提升产能水平和实行兼并重组、规范企业治理，形成良性自我发展能力。	国家企业信用信息公示系统、工信部
2024年5月28日	预估第二季 MLCC 出货量季增 6.8%，AI 服务器备货需求仍一枝独秀。 根据 TrendForce 集邦咨询观察，预期 2024 年第一季 MLCC 出货量应该是近三季的谷底，第二季 ODM 手中订单除 AI 服务器（AI Server）需求稳步成长，其余消费性电子因传统季节性的招标项目需求低，以及中国五一长假、618 电商节庆备货动能不足，表现均不如预期。整体而言，受惠于来自 AI 服务器的订单需求支撑，以及 ICT 产品需求虽不见节庆备货的高成长，但仍较第一季维持低成长，助益产能稼动率逐渐回稳，因此预估第二季 MLCC 出货量将季增 6.8%，达 12,345 亿颗，同步带动第二季营收呈现小幅成长。	TrendForce 集邦咨询
2024年5月28日	聚焦台积电 2024 技术大会：AI 芯片需求翻番，今年狂建 7 厂。 台积电亚太业务处长万睿洋表示，展望未来 AI 创新，高性能、3D 芯片堆叠、封装技术日趋重要。台积电期待未来几年内实现单芯片上超过 2000 亿个晶体管，并通过 3D 封装达到超过 1 万亿个晶体管。值得一提的是，台积电 A16 制程将搭配独家开发的背面供电 BSPDN 技术，让产出的芯片在相同速度下性能比 2nm 再高出 8%~10%；在相同面积下，能耗减少 15%~20%。台积电计划在 2026 年将 A16 导入量产，首颗芯片将用于高性能计算（HPC）芯片。台积电还预计 2024 年晶圆代工产值达 1500 亿美元，预期支持 110 万亿美元的全球经济，2030 年晶圆代工产值达 2500 亿美元并支持 1500 万亿美元的全球经济。由于 AI 和 HPC 需求旺盛，台积电目前也在积极扩张先进制程和先进封装产能。据介绍，台积电自 2022 年到 2023 年新建了五座工厂，今年在建有七座工厂，其中三个是晶圆厂、两个是封装厂，还有两个海外晶圆厂，今年台积电先进制程占 67%。	爱集微
2024年5月29日	1-4 月份，我国电子信息制造业生产稳步增长，出口恢复向好，效益持续改善，投资保持较快增长，行业整体增势明显。 1-4 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 13.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高 7.3 个和 5.2 个百分点。4 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 15.6%。主要产品中，手机产量 4.96 亿台，同比增长 12.6%，	工信部

时间	内容	来源
	其中智能手机产量 3.67 亿台，同比增长 14.1%；微型计算机设备产量 1.0 亿台，同比增长 3.4%；集成电路产量 1354 亿块，同比增长 37.2%。1—4 月份，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长 0.2%，较一季度提高 2.8 个百分点，比同期工业低 2.3 个百分点。4 月份，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长 8.4%。1—4 月份，规模以上电子信息制造业实现营业收入 4.67 万亿元，同比增长 7.9%，较一季度回落 1.2 个百分点；营业成本 4.09 万亿元，同比增长 7.3%；实现利润总额 1442 亿元，同比增长 75.8%；营业收入利润率为 3.1%，较一季度增加 0.2 个百分点。4 月份，规模以上电子信息制造业营业收入 1.2 万亿元，同比增长 11.5%；利润 433.2 亿元，同比增长 61.9%。	
2024 年 5 月 30 日	Blackwell 出货在即，CoWoS 总产能持续看增，预估 2025 年增率逾 7 成。 NVIDIA Hopper 平台 H100 于今年第一季短缺情形逐渐纾解，属同平台的新品 H200 于第二季后逐渐放量，第三季新平台 Blackwell 将进入市场，第四季扩展到数据中心客户。但今年仍以 Hopper 平台为主，包含 H100、H200 等产品线；根据供应链导入 Blackwell 平台进度，预计今年第四季才会开始放量，占整体高阶 GPU 比例将低于 10%。TrendForce 集邦咨询表示，属 Blackwell 平台的 B100 等，其裸晶尺寸 (die size) 是既有 H100 翻倍，估计台积电 (TSMC) 2024 年 CoWoS 总产能年增来到 150%，随着 2025 年成为主流后，CoWoS 产能年增率将达 7 成，其中 NVIDIA 需求占比近半。HBM 方面，随着 NVIDIA GPU 平台推进，H100 主搭载 80GB 的 HBM3，至 2025 年的 B200 将达搭载 288GB 的 HBM3e，单颗搭载容量将近 3~4 倍成长。而据三大原厂目前扩展规划，2025 年 HBM 生产量预期也将翻倍。	TrendForce 集邦咨询
2024 年 5 月 31 日	大容量存储需求看涨，带动 2024 年第一季 Enterprise SSD 营收季增逾六成。 据 TrendForce 集邦咨询研究，受到供应商减产影响，自 2023 年第四季起涌进的大容量订单需求尚未被完全满足，加上其它终端产品欲凭借建置低价库存的采购策略而扩大订单，同时，AI 服务器带动大容量存储需求明显成长，部分北美客户开始扩大采用 QLC 大容量 SSD 取代 HDD，带动第一季 Enterprise SSD 采购位元季增逾两成，在量价齐涨的情况下，2024 年第一季 Enterprise SSD 营收达 37.58 亿美元，季增 62.9%。TrendForce 集邦咨询表示，第二季 AI 服务器对大容量 SSD 的需求持续看涨，除了推升第二季 Enterprise SSD 合约价格续涨超过两成，预估第二季 Enterprise SSD 营收成长幅度仍有机会续增 20%。	TrendForce 集邦咨询

资料来源：国家企业信用信息公示系统，工信部，TrendForce 集邦咨询，爱集微，山西证券研究所

4. 风险提示

下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。

分析师承诺：

本人已在中国证券业协会登记为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本人对证券研究报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论具有合理依据。本报告清晰地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位或执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。

投资评级的说明：

以报告发布日后的 6--12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。

无评级：因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见的结果的重大不确定事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。（新股覆盖、新三板覆盖报告及转债报告默认无评级）

评级体系：

——公司评级

- 买入： 预计涨幅领先相对基准指数 15%以上；
- 增持： 预计涨幅领先相对基准指数介于 5%-15%之间；
- 中性： 预计涨幅领先相对基准指数介于-5%-5%之间；
- 减持： 预计涨幅落后相对基准指数介于-5%- -15%之间；
- 卖出： 预计涨幅落后相对基准指数-15%以上。

——行业评级

- 领先大市： 预计涨幅超越相对基准指数 10%以上；
- 同步大市： 预计涨幅相对基准指数介于-10%-10%之间；
- 落后大市： 预计涨幅落后相对基准指数-10%以上。

——风险评级

- A： 预计波动率小于等于相对基准指数；
- B： 预计波动率大于相对基准指数。

免责声明：

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于公司认为可靠的已公开信息，但公司不保证该等信息的准确性和完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，公司不对任何人因使用本报告中的任何内容引致的损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断。在不同时期，公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。公司在知晓范围内履行披露义务。本报告版权归公司所有。公司对本报告保留一切权利。未经公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯公司版权的其他方式使用。否则，公司将保留随时追究其法律责任的权利。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此声明，禁止公司员工将公司证券研究报告私自提供给未经公司授权的任何媒体或机构；禁止任何媒体或机构未经授权私自刊载或转发公司证券研究报告。刊载或转发公司证券研究报告的授权必须通过签署协议约定，且明确由被授权机构承担相关刊载或者转发责任。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此提示公司证券研究业务客户不得将公司证券研究报告转发给他人，提示公司证券研究业务客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》规定特此告知公司证券研究业务客户遵守廉洁从业规定。

山西证券研究所：

上海

上海市浦东新区滨江大道 5159 号陆家嘴滨江中心 N5 座 3 楼

太原

太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层
电话：0351-8686981
<http://www.i618.com.cn>

深圳

广东省深圳市福田区林创路新一代产业园 5 栋 17 层

北京

北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼丽泽平安金融中心 A 座 25 层

